

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2023年10月19日(19.10.2023)



(10) 国際公開番号

WO 2023/199925 A1

(51) 国際特許分類:
C08L 63/00 (2006.01) H01B 1/00 (2006.01)
C08K 3/08 (2006.01) H01B 1/22 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2023/014782

(22) 国際出願日: 2023年4月11日(11.04.2023)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2022-067364 2022年4月15日(15.04.2022) JP

(71) 出願人: 株式会社スリーボンド (THREEBOND CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1920398 東京都八王子市南大沢四丁目3番地3 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 鈴木 崇史 (SUZUKI, Takashi); 〒1920398 東京都八王子市南大沢四丁目3番地3 株式会社スリーボンド内 Tokyo (JP).
根本 崇 (NEMOTO, Takashi); 〒1920398 東京都八王子市南大沢四丁目3番地3 株式会社スリーボンド内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: I B C 一番町弁理士法人 (IBC); 〒1020082 東京都千代田区一番町10番地2 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,

HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告 (条約第21条(3))

(54) Title: ELECTRICALLY CONDUCTIVE RESIN COMPOSITION AND CURED PRODUCT THEREOF

(54) 発明の名称: 導電性樹脂組成物およびその硬化物

(57) Abstract: According to the present disclosure, provided is an electrically conductive resin composition which exhibits excellent storage stability and yields a cured product having low connection resistance. The present disclosure relates to an electrically conductive resin composition which contains components (A) to (E) and in which the organic solvent content is 1 mass% or less relative to the overall electrically conductive resin composition. Component (A): an epoxy resin having two or more epoxy groups per molecule. Component (B): a reactive diluent having one epoxy group per molecule. Component (C): rubber particles. Component (D): electrically conductive particles containing (d-1) and (d-2). (d-1): plate-type silver particles. (d-2): electrically conductive particles other than plate-type silver particles. Component (E): an epoxy curing agent.

(57) 要約: 本開示によれば、保存安定性と、硬化物の低接続抵抗値とを両立した導電性樹脂組成物が提供される。本開示は、(A)～(E)成分を含み、有機溶剤の含有量が導電性樹脂組成物全体に対して1質量%以下である、導電性樹脂組成物に関する。(A)成分: 1分子中にエポキシ基を2つ以上有するエポキシ樹脂 (B)成分: 1分子中にエポキシ基を1つ有する反応性希釈剤 (C)成分: ゴム粒子 (D)成分: 下記(d-1)および(d-2)を含む導電性粒子 (d-1): プレート型銀粒子 (d-2): プレート型銀粒子以外の導電性粒子 (E)成分: エポキシ硬化剤

WO 2023/199925 A1